



平成23年 2月14日

各 位

会社名 丸 文 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 稲 村 明 彦
(コード番号 7537 東証第一部)
問合せ先 専 務 取 締 役 岩 元 一 明
(T E L 03-3639-3010)

子会社における事業の譲受けに関するお知らせ

当社は、平成23年2月14日開催の当社取締役会において、株式会社UKCホールディングスの子会社である株式会社ユニーデバイス（以下、「ユニーデバイス」）から、サムスン電子製品の販売に関する事業を、当社100%子会社の丸文セミコン株式会社（以下、「丸文セミコン」）が譲り受けることに関する基本合意書を締結する旨決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 事業譲受けの理由

当社グループは、半導体販売を主力とするエレクトロニクス商社であります。これまで当社グループは、品揃えから技術サポート、物流管理、海外サポートなどエレクトロニクス商社に求められる機能の強化に取り組んでまいりました。平成17年には日本サムスンの特約店から半導体・電子部品の販売事業を譲り受け、メモリや液晶パネルを中心としたサムスン電子製品の拡販を推進してきました。

この度のユニーデバイスからの事業の譲受けは、国内半導体業界における競争が一段と激化する中、当社デバイス事業のサムスン電子製品の販売をさらに強化するものです。当社グループでサムスン電子製品の販売を手掛ける丸文セミコンの顧客層にユニーデバイスが持つお客様を新たに加えることで、事業規模の拡大と仕入先との関係強化を図り、磐石な営業基盤を築くことができるものと見込んでおります。

2. 事業譲受けの概要

(1) 譲受け事業の内容

サムスン電子製半導体・電子部品の販売事業

(2) 譲受け事業の経営成績^{※1}（平成22年3月期）

売上高	49,946百万円
営業利益	149百万円
経常利益	230百万円
当期純利益	154百万円

※1 ユニーデバイスとその海外子会社2社を連結した経営成績を記載しています。

(3) 譲受け資産、負債の項目

主にユニーデバイスの事業譲受日におけるたな卸資産を引き継ぎ、その他細目については今後協議の上確定します。

また、ユニーデバイスの役員及び従業員は、丸文セミコンに転籍する予定です。

(4) 譲受け価額及び決済方法

譲受け価額及び決済方法については、現在確定しておりません。

3. 株式会社ユニーデバイスの概要

(1) 商号	株式会社ユニーデバイス
(2) 所在地	東京都品川区西五反田7丁目10番4号
(3) 代表者	取締役社長 稲葉 隆志
(4) 事業内容	サムスン電子製半導体・TFT液晶等の輸出入、販売、技術サポート
(5) 設立年月日	平成8年7月1日
(6) 資本金	334百万円
(7) 純資産	2,545百万円（平成22年3月31日現在）
(8) 総資産	14,838百万円（平成22年3月31日現在）
(9) 大株主及び持株比率	株式会社UKCホールディングス 70.3%、日本サムスン株式会社 14.1%
(10) 当社との関係	資本関係、人的関係、取引関係はありません。

4. 丸文セミコン株式会社の概要

(1) 商号	丸文セミコン株式会社
(2) 所在地	東京都港区芝2丁目1番28号
(3) 代表者	取締役社長 相原 修二
(4) 事業内容	半導体・液晶パネル及び関連部品機器等の設計、製造、サービス、国内販売、輸出入
(5) 設立年月日	平成17年3月1日
(6) 資本金	301百万円
(7) 大株主及び持株比率	丸文株式会社 100.0%

5. 日程

平成23年2月14日 基本合意書締結
平成23年3月中旬（予定） 事業譲渡契約締結
平成23年6月1日（予定） 事業譲受け期日

6. 今後の見通し

今後は事業譲渡契約締結に向けて当事者間で協議を進めてまいります。
詳細につきましては、事業譲受けの正式契約締結後、明らかになり次第、別途公表いたします。
なお、本件に伴う当社の来期の連結業績に与える影響につきましては、平成23年3月期決算発表時に連結業績予想に含め公表いたします。

以上